

要約

- ダイパッドと、半導体チップと、封止樹脂とを備える半導体装置およびその製造方法が提供される。ダイパッドは、第1の面およびこれと反対の第2の面を有し、当該第2の面は露出部と当該露出部の周りの退避部とを有する。半導体チップは、ダイパッドの第1の面に搭載されている。封止樹脂は、ダイパッドの露出部を露出させつつ退避部に接してダイパッドおよび半導体チップを覆う。

4002756-4004

provisional number EL 913562208US
DATE OCTOBER 17, 2001
The following information is being deposited
with the United States Postal Service "Express Mail" Post
Office for registration under 37 CFR 1.130 in the
collection of above and is addressed to the
Commissioner of Patents and Trademarks, Washington,
D.C. 20530
CHRIS STORDAHL
Chris Stordahl
Signature